GAP PAD®

Tepelne vodivé podložky

GAP-PAD VO
Gap Pad VO vodivá podložka

- Tepelná vodivosť 0,8 - 40 W / mK
- Elektricky nevodivý
- Hrúbky 0,5 - 6,5 mm
- Dlhodobo flexibilné
- Výhodné pre opravy

POPIS PRODUKTU

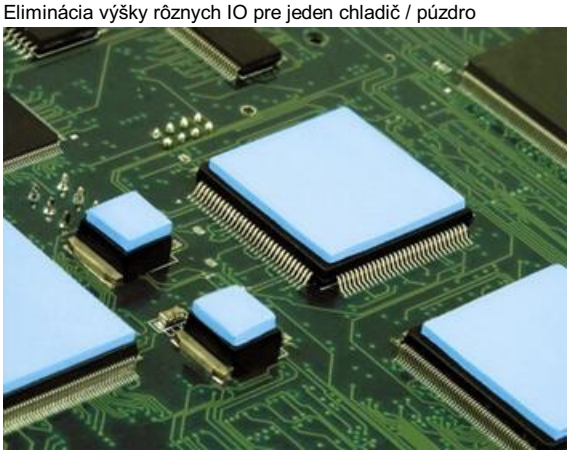
Gap Pad® - tepelne vodivá, elektricky nevodivá flexibilná podložka sa používa všade tam, kde potrebujete vyplniť priestor a odvádzať teplo. Vďaka svojej flexibilite a hrúbke ju možno umiestniť medzi tlačený spoj a chladič, materiál sa prispôsobí nerovnostiam povrchu (SMD súčiastky, vývody, vodiče ap.) A účinne odvádza teplo z celého povrchu tlačeného spoja. Gap Pad zostáva dlhodobo flexibilná a eliminuje tepelnú rozťažnosť okolitých súčastí. Pracovná teplota je od - 60 ° C do 200 ° C

Na rozdiel od zalievacích hmôt nemusíte riešiť "uzatvorenie priestoru" a dobu vytvrdnutia materiálu, je ďaleko jednoduchšie prípadná oprava zariadení a vďaka možnosti selektívneho použitia môžete znížiť hmotnosť zariadenia.

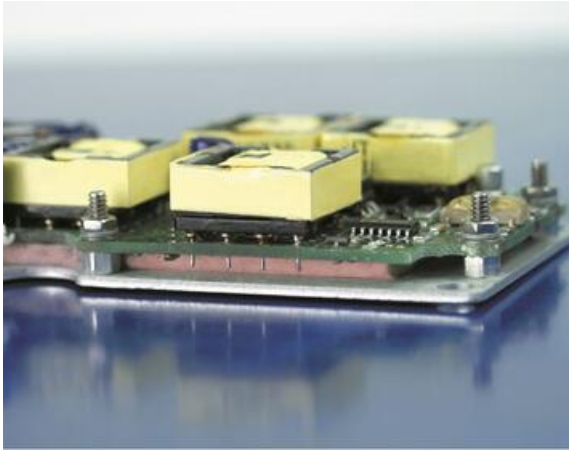
Tepelne vodivé podložky dodávame v rôznych hrúbkach, tvrdostiach, s rôznou tepelnou vodivosťou a v rôznych formátoch podľa požiadavky zákazníka.

Príklady použitia:

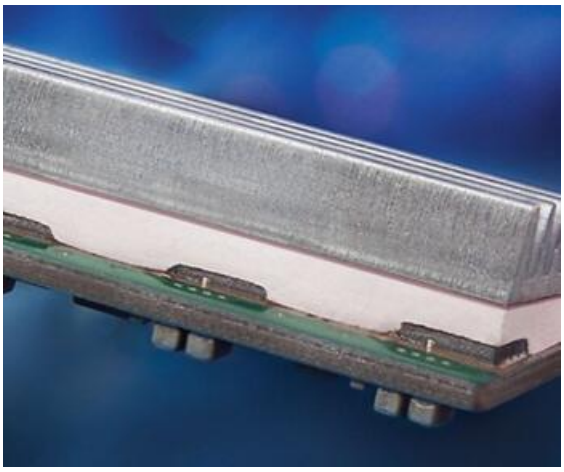
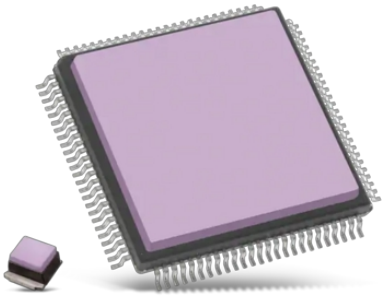
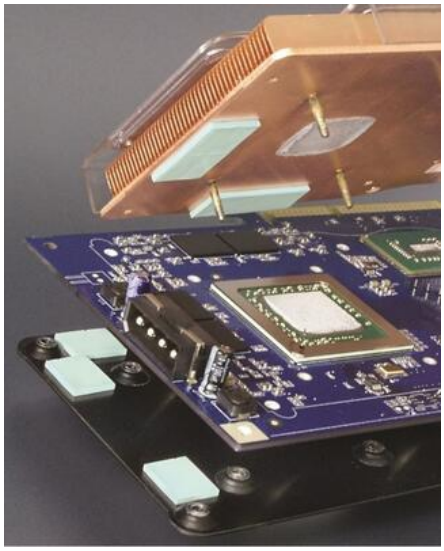
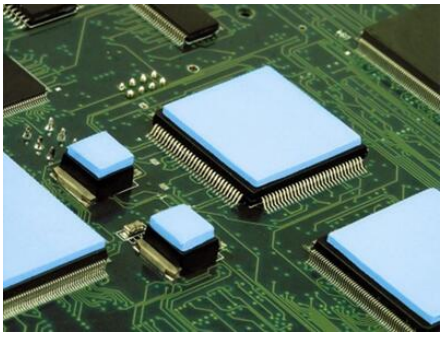
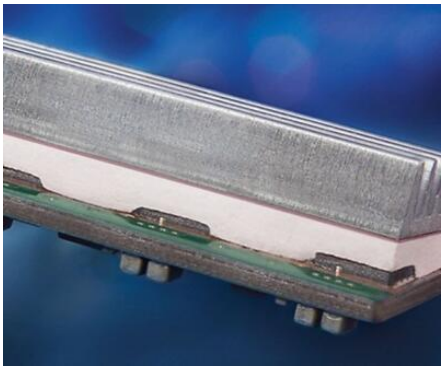
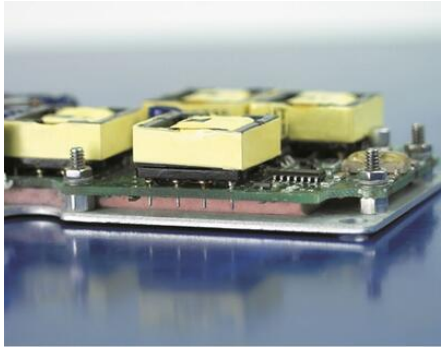
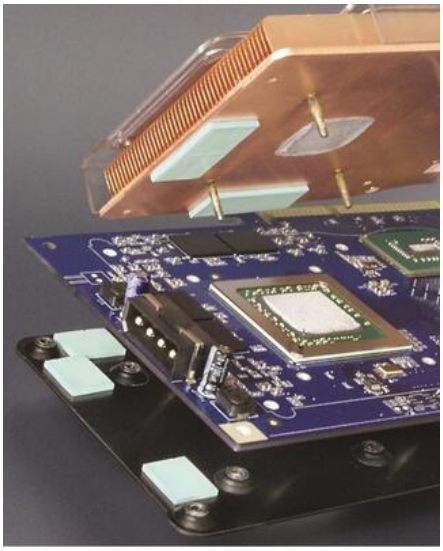
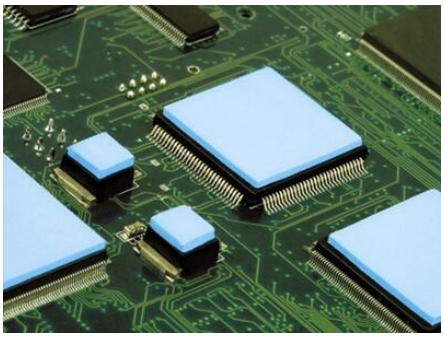
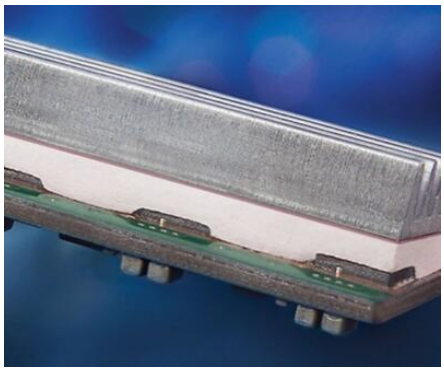
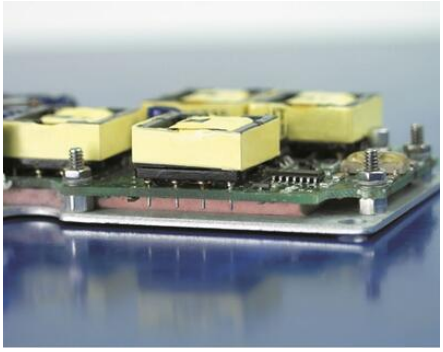
Eliminácia výšky rôznych IO pre jeden chladič / púzdro



Chladenie celého tlačeného spoja



Globálne chladenie IO



Materiál sme schopní dodať v niekoľkých podobách podľa potreby zákazníka.